

Полупроводниковая Корзина Для Очистки Из Птфэ 12 Дюймов, Подложка Для Мокрого Травления, Стойкая К Кислотам И Щелочам, Фторполимерный Держатель

Артикул: PL-CP81



введение

Разработанная для высокочистых полупроводниковых сред, эта 12-дюймовая корзина для очистки пластин из ПТФЭ обеспечивает исключительную химическую стойкость в критических процессах мокрого травления и очистки. Индивидуально изготовленная конструкция обеспечивает надежную поддержку пластин и максимальное воздействие жидкости для прецизионного производства.

[Узнать больше](#)

Применение	Описание	Ключевое преимущество
Очистка RCA	Стандартная последовательность (SC-1 и SC-2) для удаления органических загрязнений и металлических примесей.	Предотвращает повторное загрязнение при переходах от высокого pH к низкому и наоборот.
Травление HF	Удаление сапфировых оксидных слоев или нативных оксидов с использованием растворов плавиковой кислоты.	Полная невосприимчивость к воздействию HF обеспечивает долгосрочную работоспособность оборудования.
Травление пиранхой	Высокотемпературное смешивание серной кислоты и перекиси водорода для удаления фоторезиста.	Выдерживает экстремальные экзотермические реакции без размягчения структуры.
Промывка после ХМП	Удаление частиц суспензии и химикатов после химико-механической полировки.	Минимальное количество точек контакта предотвращает захват частиц за пластиной.
Текстурирование солнечных элементов	Кислотное или щелочное текстурирование кремниевых пластин большого формата для улучшения поглощения света.	Высокая долговечность при больших объемах в условиях постоянного химического воздействия.
Изготовление МЭМС	Глубокое мокрое травление кремниевых или стеклянных подложек для создания микромеханических структур.	Обеспечивает равномерную скорость травления благодаря оптимизированной циркуляции жидкости.
Фотолитография	Проявление и снятие материалов фоторезиста с использованием специализированных органических растворителей.	Стойкий к растворителям материал предотвращает выщелачивание органических веществ в проявитель.
Мегазвуковая очистка	Высокочастотная акустическая очистка для удаления субмикронных частиц с поверхностей пластин.	Плотность материала эффективно передает акустическую энергию без демпфирующих эффектов.

Характеристика	Детали спецификации (PL-CP81)
Основной материал	Высокочистый первичный ПТФЭ (политетрафторэтилен)
Совместимость с диаметром пластин	300 мм (12 дюймов) — индивидуальные размеры доступны по запросу
Конфигурация	Держатель для одной пластины / Конфигурация корзины для нескольких пластин
Производственный процесс	Прецизионная обработка на станке с ЧПУ / Индивидуальное изготовление

Применение	Описание	Ключевое преимущество
Характеристика	Детали спецификации (PL-CP81)	
Химическая стойкость	Полный диапазон (pH 0-14); устойчив к HF, HNO ₃ , HCl, H ₂ SO ₄ , KOH и т.д.	
Рабочая температура	Постоянное использование до 260°C (Индивидуальные пределы в зависимости от конструкции)	
Шаг паза / Расстояние	Полностью настраивается в соответствии с требованиями к потоку жидкости или вместимости	
Тип контакта	Доступны конструкции с точечным или краевым контактом	
Варианты ручек	Фиксированные, съемные или интерфейс фланца для автоматизированных роботов	
Отделка поверхности	Сверхгладкая обработанная поверхность для минимизации адгезии частиц	
Стандарт чистоты	Соответствует полупроводниковому классу; доступен анализ на следы металлов	